

半导体材料研发中心项目 环境影响评价公众参与说明

建设单位：昆明国兴半导体有限公司

2025 年 3 月

目 录

1 概述..... 1

2 首次环境影响评价信息公示情况..... 2

 2.1 公开内容及日期..... 2

 2.2 公开方式..... 2

3 征求意见稿公示情况..... 3

 3.1 公示内容及时限..... 3

 3.2 公示方式..... 4

 3.3 查阅情况..... 7

 3.4 公众提出意见情况..... 7

4 其他公众参与情况..... 8

5 公众意见处理情况..... 8

6 其他..... 8

8 诚信承诺..... 8

1 概述

昆明国兴半导体有限公司成立于 2023 年 9 月 25 日，注册地位于云南省滇中新区秧旺街滇中新区空港智园项目（一期）1 幢 1 层 101-30。经营范围包括一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用材料制造；集成电路芯片及产品制造；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），公司统一社会信用代码为 91530100MACXAUMG6R。

昆明国兴半导体有限公司拟投资 23000 万元在云南滇中新区临空产业园滇中新区医疗器械产业园内租用云南滇中新区临空产业园空厂房，用于从事半导体材料研发及生产活动，项目租用厂房建筑面积为 4000.00m²，建设年产硅外延片生产线 1 条，建成后年产硅外延片 3 万片。2024 年 5 月，昆明国兴半导体有限公司委托北京中瑞高科技产业服务有限公司完成了《昆明国兴半导体有限公司半导体材料研发中心项目可行性研究报告》，2024 年 8 月 9 日，昆明空港经济区管理委员会（云南滇中新区经济发展局）对半导体材料研发中心项目核发了投资备案证（详见附件 2），项目代码为 2408-530200-04-01-245176。本工程计划于 2024 年 11 月开工，2025 年 1 月建成使用，建设工期 2 个月。

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 10 月 1 日）国务院令第 682 号等相关法律法规的有关要求，需对昆明国兴半导体有限公司半导体材料研发中心项目进行环境影响评价，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业，第 81 项电子元件及电子专用材料制造 398”中涉及“半导体材料制造”的项目，应编制环境影响报告书。

2024 年 8 月 22 日我公司委托云南江楚环保科技有限公司进行《半导体材料研发中心项目环境影响报告书》编制工作。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）、关于发布《环境影响评价公众参与办法》配套文件的公告（生态环境部公告 2018 年第 48 号）以及云南省生态环境厅关于贯彻执行《建设项目环境影响评价技术导则 总纲的

通知》对环境影响评价公众参与制定的相关规定和要求，为了推进和规范环境影响评价活动中的公众参与，我单位在委托环评单位编制《半导体材料研发中心项目环境影响报告书》之日起7个工作日内，在项目区所在地进行了公众参与调查第一次公示，同时在项目初稿编制完成后，通过网络平台、报纸刊登及现场粘贴的方式发布了公众参与调查第二次公示内容，包括环境影响报告书征求意见稿与公众参与调查表，进行了公众意见征询工作，在此基础上编制了本项目环境影响评价公众参与说明。

2 首次环境影响评价信息公示情况

2.1 公开内容及日期

我单位于2024年8月22日委托云南江楚环保科技有限公司承担本项目环境影响评价文件的编制工作，并于2024年9月2日，在云南滇中新区政府官方网站<http://www.dzxq.gov.cn/>进行了第一次环境影响评价信息公告。

公开的内容主要包括①建设项目基本情况；②公众意见表的网络连接；③环境影响评价的主要工作程序和主要工作内容；④建设单位的名称和联系方式；⑤征求公众意见的主要事项；⑥公众提出意见的主要方式。

2.2 公开方式

2.2.1 网络

公示网站：云南滇中新区政府官方网站

网络连接：<http://www.dzxq.gov.cn/c/2024-09-02/6897614.shtml>

公示时间为：2024年9月2日—2024年9月13日。



图 2-1 首次公示网络截图

2.2.2 其他

项目环境影响评价公众参与第一次公示未采取其他方式进行公示征求意见。

2.2.3 公众意见情况

在项目发布环境影响公众参与第一次公示的规定时间内, 均未收到公众向我公司提出的与本项目环境影响评价相关的意见。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

环评单位完成《半导体材料研发中心项目环境影响报告书》初稿后, 在 2024 年 11 月 5 日-2024 年 11 月 18 日, 我公司在云南滇中新区政府官方网站 <http://www.dzxq.gov.cn/>进行了第二次环境影响评价信息公告及《半导体材料研发中心项目环境影响报告书》(征求意见稿)。2024 年 11 月 13 日和 2024 年 11

月 14 日，两次在春城晚报进行了报纸公示，并同时在云南省滇中新区秧旺街滇中新区空港智园公示公告栏以张贴公告的形式发布了环境影响评价第二次信息公告。

公示主要包括：①《半导体材料研发中心项目环境影响报告书》（征求意见稿）的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；②征求意见的公众范围；③公众意见表的网络链接；④公众提出意见的方式和途径；⑤公众提出意见的起止时间等。

公示时限：2024 年 11 月 5 日-2024 年 11 月 18 日，共 10 个工作日。

本次《半导体材料研发中心项目环境影响报告书》（征求意见稿）公示发布内容与时限符合《环境影响评价公众参与办法》第十条内容的相关要求。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

公示网站：云南滇中新区政府官方网站

网络连接：<http://www.dzxq.gov.cn/c/2024-11-04/6926152.shtml>

公示时间为：2024 年 11 月 5 日—2024 年 11 月 18 日。



图 3-1 项目征求意见稿网络公示截图

3.2.2 报纸

我单位分别于 2024 年 11 月 13 日和 2024 年 11 月 14 日, 两次在春城晚报进行了报纸公示, 报纸截图如下。



图 3-2 本项目征求意见稿第一次报纸公示截图

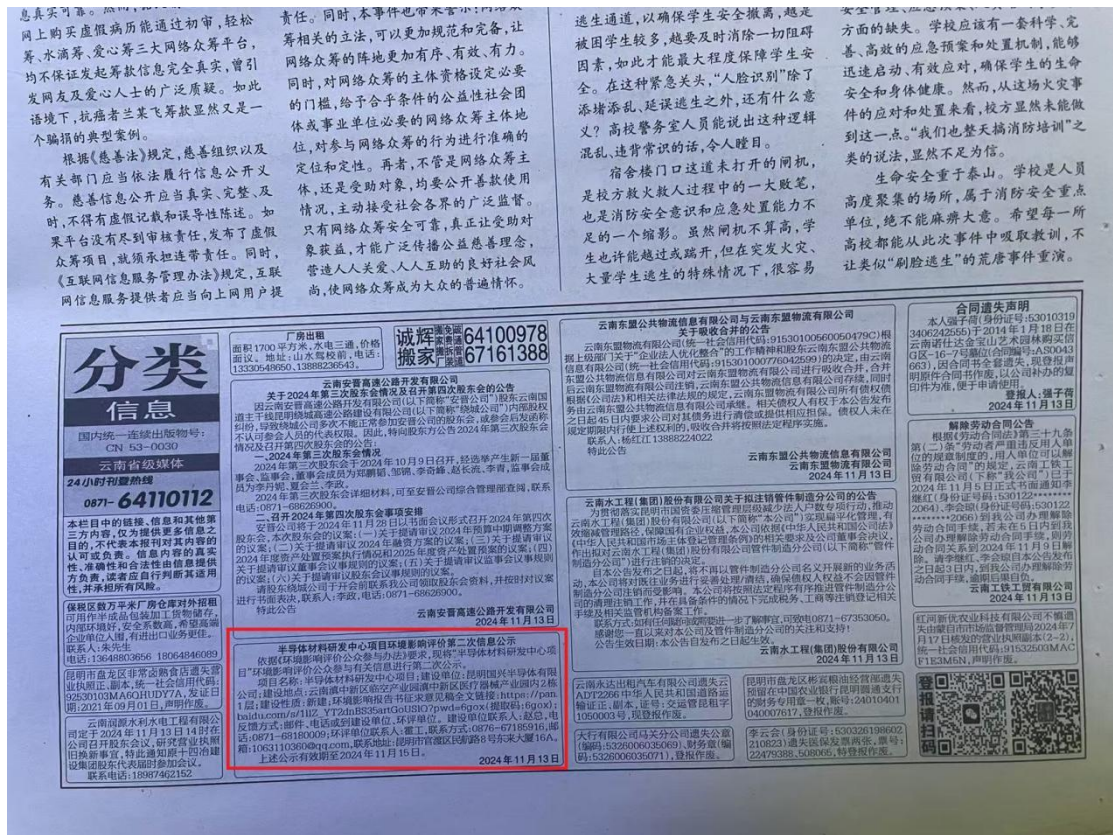


图 3-3 本项目征求意见稿第二次报纸公示截图

3.2.3 张贴公告

我单位在2024年11月4日在云南省滇中新区秧旺街滇中新区空港智园公示公告栏以张贴公告的形式发布了环境影响评价第二次信息公告，现场照片如下。

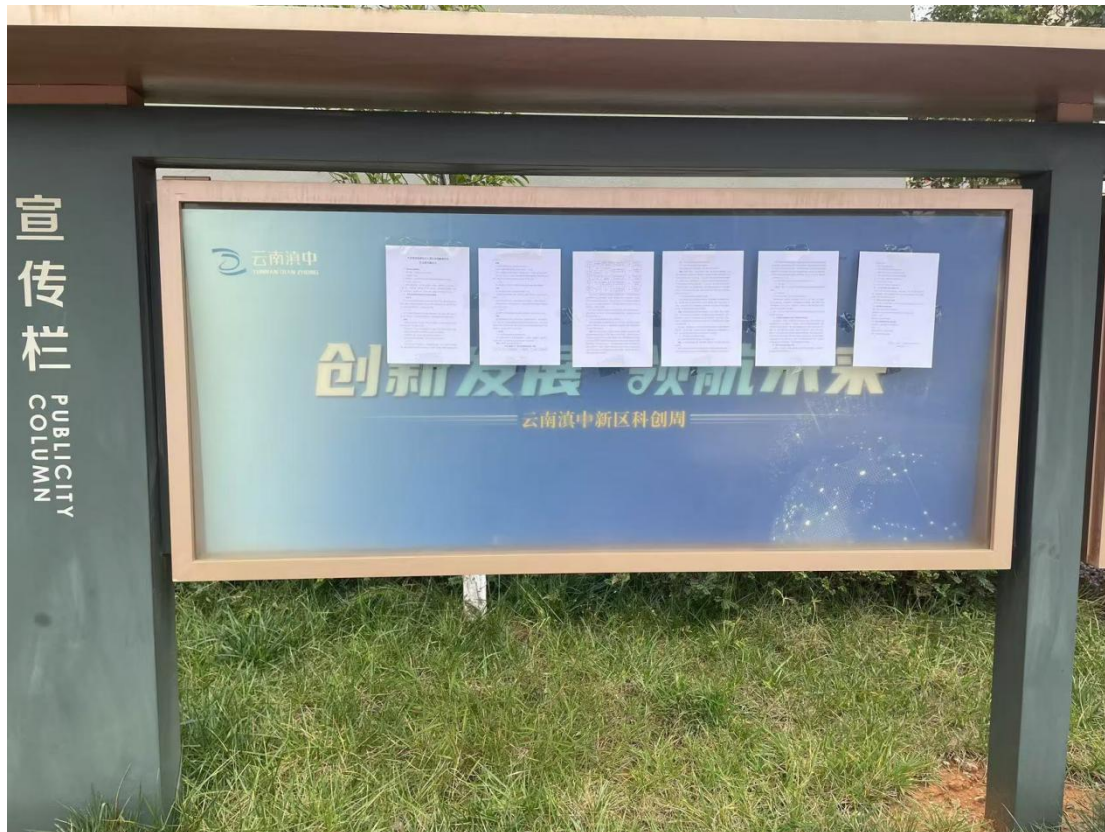


图 3-4 本项目征求意见稿滇中新区空港智园公示公告栏粘贴公示

3.3 查阅情况

公示期间，我公司在昆明国兴半导体有限公司办公室设置《半导体材料研发中心项目环境影响报告书》（征求意见稿）纸质版查阅场所，并未有公众联系索要纸质版报告或进行现场查阅。

3.4 公众提出意见情况

在项目发布环境影响公众参与征求意见稿征求意见的规定时间内，均未收到公众向我公司提出与本项目环境影响评价相关的意见。

4 其他公众参与情况

我公司在发布本项目环境影响评价公众参与第一次公示及《半导体材料研发中心项目环境影响报告书》（征求意见稿）全文公示进行征求意见规定时间内，未收到公众通过电子邮件、信函、电话、传真以及其他方式反馈对本项目建设环境影响方面质疑性意见，我公司不需要组织开张深度公众参与。

5 公众意见处理情况

我公司在发布本项目环境影响评价公众参与第一次公示及《半导体材料研发中心项目环境影响报告书》（征求意见稿）全文公示进行征求意见规定时间内，未收到公众通过电子邮件、信函、电话、传真或者其他方式反馈对本项目建设环境影响评价有关的公众意见。

6 其他

我单位已将环境影响公众参与第一次公示内容、《半导体材料研发中心项目环境影响报告书》（征求意见稿）网络公示报告、报纸公示及现场张贴内容存档备查。

8 诚信承诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在《半导体材料研发中心项目环境影响报告书》编制阶段开展了公众参与工作，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《半导体材料研发中心项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由昆明国兴半导体有限公司承担全部责任。

承诺单位：昆明国兴半导体有限公司

承诺时间：2024 年 11 月 26 日